

～ M E C のこれまでとこれから ～

開催日時： 2025年3月29日（土曜日）

出席者：	メ	ッ	ク	代表取締役社長	前	田	和	夫
	メ	ッ	ク	取締役常務執行役員	住	友	貞	光
	メ	ッ	ク	執行役員 経理財務本部長	北	氏	克	明
	メ	ッ	ク	コーポレートコミュニケーション室室長	松	下	綾	

2024年12月期概況について

2024年12月期の事業環境を総括しますと、生成 AI 関係向けに当社技術の最先端品が適用され始めた年となりました。生成 AI 関係は好調で、パソコンやスマートフォンは少し回復しました。中長期的には、通信革命によるデジタル技術進展のメガトレンドは不変であり、それらに向けた投資は継続されると見込んでいます。

決算の概要については、前年比で増収・増益となり、売上高、営業利益、共に過去最高でした。主要製品の概況については、CZ シリーズは最先端パッケージ基板向け需要が拡大し、汎用的なサーバー、パソコン向けの製品需要は回復基調にありました。V-Bond(以下「VB」)は、車載基板や衛星関連基板向けに堅調、EXE と SF は回復基調で推移しました。その結果、売上高は182億3千万円、営業利益は45億6千万円となりました。当期純利益は、子会社である MEC (HONG KONG) LTD.の解散および精算、MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.の完全子会社化に係る税金計上により法人税等が増加し22億9千万円となりました。

会社概要について

主な事業は、電子基板や電子部品の製造に使用する薬品の開発、製造・販売です。本社は兵庫県尼崎市にございます。

社名、社是、経営理念について

社名の由来は機械 (Machinery)、電子 (Electronics)、化学 (Chemistry) を融合させた総合技術で社会に挑むということで、それらの頭文字を取って、メック (MEC) としました。社是は「仕事を楽しむ」、経営理念は「独創の技術」、「信頼の品質」、「万全のサービス」です。

当社の事業について

当社は主に、電子基板・電子部品に使用される化学薬品を開発し、製造・販売しています。研究開発に力を入れ、単体従業員の3分の1が研究開発に携わっています。金属を溶かす技術が主力で、半導体後工程の有機パッケージ基板の製造において重要な薬品プロセスを提供し、独占的なシェアを維持しています。

海外にも生産拠点を保有し、どの生産拠点においても同じ品質の製品が製造できる生産体制を敷いています。なお、当社は基板メーカーでもなく、メッキ技術も持ちません。

当社製品の流れについて

研究開発で作った配合表をもとに、自社工場でスケールアップし出荷しています。荷姿はポリ容器・タンクです。お客様は主に基板メーカーや部品メーカーです。最終的に様々な電子機器に組み込まれ、皆さんが持っておられる電子機器に高い確率で当社が関わっています。

拠点について

海外拠点は、中国は蘇州と珠海、台湾、タイ、ベルギーに子会社があり、工場を併設しています。日本国内拠点は、本社に研究所と工場、新潟県長岡市に量産工場があり、東京には営業所を置いています。2026年末に福岡県北九州市に工場を稼働する予定です。

創業からの売上推移について

創業以来、凸凹はありますが、基本的には右肩上がりです。パソコンが伸びた時、スマートフォンが伸びた時、そして5Gや自動運転アシスト等、物事・社会が変わっていく中で業績を伸ばしています。

当社のコア技術について

1. 銅表面を粗化し、密着性を向上させる技術

主力製品であるCZは、主にパッケージ基板、VBは主に一般基板に使用されています。

2. 配線を形成する技術

EXEは、微細な配線を形成する際にきれいな形でエッチングが可能になる薬品です。

3. 選択エッチング技術

SFは、同じ基板上に異なる金属が使用されている場合に、特定の金属だけを溶かし、他の金属を溶かさないといった技術です。

4. 化学的に密着性を向上させる技術

1の技術のCZと同様に銅と樹脂の密着性を向上する目的で使用される技術です。銅表面を粗化せず化学的な密着により銅と樹脂を結合させる新しいコア技術です。

主要製品と最終製品例、活躍できる分野について

CZは様々なテクノロジーに結び付いています。VBは車やスマートフォン、衛星通信などに使用されています。EXEはテレビやパソコン、フラットパネルディスプレイのモニターなどに使用されています。SFはタブレットPCのタッチセンサーなどに使用されています。様々な分野で当社の製品プロセスが使われ、最終用途は多岐にわたっています。

連結業績推移について

2025年12月期の業績は、売上高200億円、営業利益50億円、純利益36億円を計画しています。

売上構成について

薬品売上が95.9%を占め、そのうちCZシリーズが64.7%を占めます。地域セグメント別売上高については、日本（韓国への輸出も含む）、中国、台湾が主力であり、今後は東南アジア地域に期待しています。

成長のキーワードと売り上げ拡大のステップについて

次世代通信ネットワークについては、最近では衛星通信向けも増加しています。IoT、AIの進展によりエッジ AI などが伸びていくと注視しています。次世代モビリティでは、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転車が非常に重要です。世界的な半導体需要の増加に伴い、半導体メーカーの投資が進み、当社の顧客となる基板メーカーでも大きな投資が進む、その結果、当社の業績を拡大する機会が増える見通しています。

新拠点について

北九州工場は当初より計画を遅らせています。理由は、事業拡大を見据えた生産能力を確保することに加え、足元で新製品の需要が増加している状況を鑑み、設計を変更したためです。稼働は2026年12月の予定で、お客様の承認等を得て、その1年後ぐらいに本格稼働ができる計画です。

電子基板とメックの強い領域について

電子基板は、様々な機器に使用されており、当社の中でも、パッケージ基板に強みを持っています。今後は更に通信ネットワークの高速情報処理が求められ、高多層基板、多層基板が非常に重要になると考えています。その領域において、当社新技術の適用を進めています。

パッケージ基板と CZ について

パッケージ基板の断面写真です。白く見える部分が銅であり、その表面に当社薬品 CZ が使用されています。CZ で銅表面を少し溶かし独特な凹凸形状にすることで、銅と樹脂との密着性が高まり、剥がれを防止します。

パッケージ基板の進化について

パッケージ基板は様々なタイプの製品が出てきています。パッケージ基板の進化によって、総じて基板サイズは大型化、基板総数は増加し、当社薬品の使用量も増えると考えています。

CZ シリーズのロードマップ

現在の主力製品は CZ-8101 です。直近では最先端の CZ-8401 プロセスが使用され始めました。現在、開発に注力しているものは化学密着タイプです。銅表面を粗化せず密着性を向上させる薬品です。

事業領域の拡大を目指して

技術の変化に対応し、深掘りすることに最も注力しています。既存技術の応用展開では、より半導体製造に近い市場を狙って取り組んでいます。

中期経営計画

ミッションとビジョンについて

当社は、ミッション「界面から世界を変える」、ビジョン「界面の創出と接合で世界一に

なる」を掲げています。

目指す企業像について

ビジョン「界面の創出と接合で世界一になる」は、当社技術は他に類を見ないものであり、今後も他社が真似できないような仕事を創造していくという意味です。

目指す企業像として3つ示しています。「真のグローバルカンパニーになる」は、様々な変化のある中でも、世界全体を見据えて仕事に取り組む会社を目指していくという意味です。「研究開発型企業であり続ける」は、研究開発を大事にする企業で在り続けるということであり、「独創の AI 企業としての顔を持つ」は、AI を電子基板で支える側だけでなく、AI を活用し開発に取り組む、根拠の裏付けを理論的に構築し、お客様に提供していくそのような意味です。

本中期経営計画（Phase 2）の位置づけについて

2025年12月期から中期経営計画 Phase 2 が始まりました。Phase 1 では、重点領域を深堀し、収益性を確保しながら新技術を開花させるべく進めてまいりました。Phase 2 では新技術での地位確立や、既存技術の応用展開を進めていきます。

Phase 2（2025年～2027年） 目標

定量目標は2027年12月期に、売上高250億円、連結営業利益率は20%よりも高いところを目指し、最低でも20%を確保、ROE10%以上を目標としています。定性目標は、既存市場で収益性を維持・強化を掲げ、お客様との関係性強化、超微粗化系密着向上処理のシェア維持、無粗化技術・化学密着領域におけるソリューション確立、環境配慮薬品への取り組みを進めていきます。また、新規事業の創出、既存技術の応用展開、グローバル安定供給体制の確立を目指します。

資本政策について

研究開発については、連結売上高の約10%を投資することを念頭に置いています。設備投資は2025年から2027年までで80億円を投資する予定です。株主還元は、連結配当性向30%を目標とし、自己株式取得は機動的に実施していきます。株主さまへの還元として、2025年12月期は1株当たり年間配当金55円を予想しています。

質疑応答

質問：為替について

回答：当社は、USドルの取引は少なく、台湾ドルと中国元の影響が大きいです。台湾ドルは4.72円、中国元は21.04円でした。2025年計画については、台湾ドルは4.76円、中国元は21.08円の前提です。基本的に、円安は当社収益を押し上げる方向に働きます。

質問：中期経営計画について、営業利益20%以上、ROE10%以上の目標は控えめではないのか

回答：目標値について、実績がすでに上回っているという点は、最低限の目標値として開示しているもので、上回るように実績を上げていきたい。

質問：北九州工場の量産時期について

回答：新しい設備で生産した製品は、お客様の承認が必要です。承認にはおおよそ1年かかるとみています。

質問：売上が減少する要因・リスクとして考えられるものを教えてほしい

回答：半導体産業の景気動向以外のリスクでは、当社は研究開発に積極的に投資しています。市場ニーズの分析を誤り、開発した製品が売れなければ投資資金を回収できないリスクがあります。また、独占的に供給している製品があり、急激な需要の増加に対応するためにも生産能力は余力を持たせて運用しています。

質問：CZ シリーズのシェア維持について

回答：今後もシェアを維持し、市場拡大でさらに売上を伸ばしていきたい。お客様と向き合い、求められている需要を理解し対応していきます。

質問：多層基板向けのシェアについて

回答：多層基板用の薬品は様々なメーカーが提供しており、現時点での当社シェアは高くありません。今後、多層基板は今まで以上に高速情報通信処理のニーズが高まると考えています。当社の新技術が貢献する余地があり、シェアを獲得できると考えています。

質問：無粗化技術について

回答：製品プロセスはほぼ完成しています。完全無粗化技術については、ニーズを踏まえ今後も改良が続くと考えています。

質問：人財採用について、思うように進んでいるのか

回答：今のところ進んでいます。また、採用だけでなく社内の人財も育てています。今後、採用環境は厳しくなっていくと考えており、戦略的に環境を整えていきたい。

質問：薬品が漏れるなど、危険なことにならないのか

回答：外部への流出が起こらない構造です。また、阪神淡路大震災の被害を受けた阪神地域に本社があり、阪神淡路大震災レベルの地震は問題がない構造になっています。できる限りの対策を取っており安心いただきたい。

質問：低電力消費に向けた技術について教えてほしい

回答：低消費電力については、当社技術を使い電子基板を製造することによって電気信号をスムーズに送ることができること、電子機器を小型にすることができる、これら2つの理由によって、低消費電力に貢献できると考えています。

質問：無粗化技術について教えてほしい

回答：無粗化技術は、金属表面を粗化する密着メカニズムとは異なり、薄い被膜により分子レベルで金属と樹脂を結合させる技術です。